

Helios

Inspektions- und Messmodul für die Waferprüfung

Je später ein Defekt im Wafer auffällt, desto teurer wird er. Helios findet Risse und Beschädigungen, bevor sie zum Problem werden: Der Wafer wird per Vakuum auf der Heizplatte fixiert, nach Rezept kontrolliert erhitzt und unter strukturiertem Licht Schritt für Schritt aufgenommen. Die intelligente Objekterkennung macht Risse und Beschädigungen sichtbar und dokumentiert jedes Ergebnis nachvollziehbar.

SO LÄUFT DIE PRÜFUNG

Fixieren und erhitzen: Der Wafer wird per Vakuum auf der Heizplatte fixiert und nach Rezept mit definierten Rampen- und Haltezeiten auf Solltemperatur gebracht.

Belichten und aufnehmen: Die Domleuchte projiziert ein Strichmuster auf den Wafer; die Kamera nimmt Serienbilder auf, während die Linearachse ihn schrittweise bewegt.

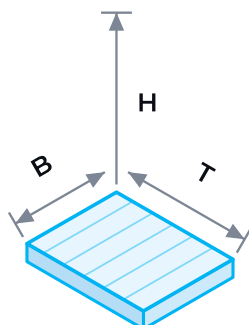
Auswerten und dokumentieren: Die Auswertung erkennt Risse und Beschädigungen in den Aufnahmen und dokumentiert das Ergebnis nachvollziehbar für jeden Wafer.



TECHNISCHE DATEN

Funktion	Inspektion und Vermessung von Wafern unter Temperatur
Waferaufnahme	Fixierung per Vakuum auf der Heizplatte
Heizung	rezeptgesteuert mit definierten Rampen- und Haltezeiten
Optik	Domleuchte mit Schlitzblende, Kamera, Linearachse
Auswertung	intelligente Objekterkennung, Chart-Monitoring in Echtzeit, Datenexport
Steuerung	integrierter IPC mit Rezeptverwaltung
Schnittstellen	Ethernet, EtherCAT, SECS, API, FDC, digitale I/O
Sicherheit	sicherheitsüberwachte Tür, USV-Versorgung der gesamten Anlage
Umgebung	Reinraum bis einschließlich ISO 5, 24/7-Dauerbetrieb, redundanter Aufbau

FUßABDRUCK


0,76 m
Breite
0,99 m
Tiefe
1,32 m
Höhe

Stellfläche ohne auskragende Anbauten.